

## 贴片SMD型LED使用说明书

感谢您使用深圳市天成照明有限公司的系列LED产品，为了增进您对我公司产品特性的了解，方便您在使用过程中掌握其特性，减小或避免因人为因素造成的不必要产品损坏或性能不匹配，特在此说明：

### 1、物料确认

使用前确认LED BIN等级是否符合要求。例：电压 亮度 色区等参数是否属于同一等级，同一等级产品应在一起使用。若非同一等级的LED产品应用在同一物件上，应评估其适用性（若不同的电压BIN在一起使用亮度可能有差异，不同色区在一起使用发光颜色可能会有差异）

### 2、包装存储

拆包装前避免湿气进入LED内部，建议SMD系列的LED存放在有干燥剂的防潮柜中，存放条件为：温度 5-30℃，湿度 35-60%

### 3、使用过程中预防措施

使用前请确认真空包装是否完好，如有包装破损漏气请及时联系我司换货，不可直接使用；确认真空包装完好，包装日期距拆包日期2月内无需除湿（时间超过2月不可直接使用），使用遵从“用多少拆多少，用一包拆一包”的原则，拆包后的灯珠应尽快在8h内使用完，余料请重新密封后，放置在湿度低于30%，温度10-30℃的环境中保存

### 4、焊接条件

本产品过回流焊温度建议260℃以下，推荐温区为200-245℃，同时建议客户使用低温锡膏。回流焊次数建议小于2次，首次回流焊后须冷却至室温后方可进行第二次回流焊，贴板结束后2H内必须过回流焊，如若需要返工线路板需控制在过回流焊后12H内，不可过度裸露空气中。不建议将本产品应用于弯曲的线路板上。焊接时避免快速冷却，LED焊接冷却过程中避免任何形势的机械力或过度震动，焊接后，不可弯曲线路板

### 5、静电防护

LED是静电敏感电子原器件，应采取静电防护措施。例：在使用过程中佩戴静电环。所有设备、仪器应接地。建议在组装后的成品做静电受损测试

### 6、强烈建议

客户在使用本产品的过程中，请先小批量试用，成品在经过各种测试合格后，再大批量投入使用

### 7、其他注意事项

LED长期暴露在阳光或偶尔暴露在紫光下可能导致胶体变黄，为了确保LED光电性能，请保持LED发光区表面清洁。在设计电路时应预防开关过程中产生的逆向电压或大电流对LED瞬间冲击，在使用过程中避免镊子等锋利工具触碰胶体部分